



平成 21 年 1 月 19 日

各 位

会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 飯 塚 哲 哉
(JASDAQ・コード番号：6769)
問い合わせ先 取締役業務部長 高 田 康 裕
電 話 番 号 0 3 - 3 2 7 0 - 0 6 6 6

ウィンボンド・エレクトロニクス社の画像信号処理事業の譲受および 株式取得による子会社化に関するお知らせ

当社は、ウィンボンド・エレクトロニクス社（華邦電子股份有限公司、本社：台湾台中科学工業園区、CEO：Arthur Yu-Cheng Chiao、以下「ウィンボンド社」。）との間で基本合意に至っておりますウィンボンド社および関係会社が保有する画像信号処理（ISP: Image Signal Processor）事業の譲受について、本日開催の当社取締役会で最終的に決議し、正式に実施する旨の合意契約を締結しましたのでお知らせいたします。

1. 事業の譲受および株式取得の理由

当社は、大容量デジタル信号の高速インターフェース技術に優位性を持つ事業展開をしております。ウィンボンド社の優れた ISP 技術開発チームとの間でのシナジーを獲得することにより、次世代インターフェース技術と画像処理技術を融合した製品開発を展開し、カメラ付携帯機器、携帯電話端末等の市場に加え、セキュリティ、車載監視システム、アミューズメント等今後成長の見込める画像処理応用分野において新たな付加価値をお客様に提供することを目的として事業の譲受を行うこととしました。

2. 事業の譲受および株式取得の概要

(1) 譲受部門の内容

ウィンボンド社画像信号処理（ISP: Image Signal Processor）事業

(2) 譲受部門の主な経営成績

平成 19 年 12 月期における譲受部門の売上高は 971 百万円です。

(3) 譲受および株式取得の決済方法

譲受および株式取得に際しての決済方法は現金決済です。

事業の譲受に当たっては、ウィンボンド社日本法人が新設した株式会社に資産を譲渡し、当社がその株式取得を行う方法により行います。

3. 事業の譲受および子会社化の日程

平成 20 年 11 月 5 日	事業譲受に関する基本合意承認取締役会
平成 20 年 11 月 14 日	事業譲受基本契約締結
平成 21 年 1 月 19 日	事業譲受期日等条件合意書締結
平成 21 年 1 月 20 日	事業譲受期日（子会社化）

4. 事業譲受後の子会社の概要

(1) 商号	ザイン・イメージング・テクノロジー株式会社 (平成21年1月20日に上記に商号変更予定)
(2) 代表者	代表取締役 加藤雅弘 (予定)
(3) 本店所在地	東京都中央区日本橋本町3-3-6
(4) 設立年月日	平成20年7月23日
(5) 事業の内容	半導体企画・設計・製造・販売
(6) 事業年度の末日	12月末
(7) 従業員数	9名(平成21年1月21日時点(予定))
(8) 資本金の額	1,000千円
(9) 株主構成	ザインエレクトロニクス株式会社 100%所有

※事業譲受期日より前の所有株式はありません。

5. 今後の見通し

この事業譲受による平成21年12月期の当社業績に与える影響については現在精査中です。確定次第お知らせいたします。

(参考) ウィンボンド社の概要

商号	華邦電子股份有限公司 (Winbond Electronic Corporation)
Chairman and CEO	Arthur Yu-Cheng Chiao
本店所在地	台湾 台中科学工業園区
主な事業の内容	DRAM 製品ビジネス、フラッシュメモリー製品ビジネス、メモリーIC 製造サービスビジネス
当社との関係	人的および資本的關係はありません。

ご注意:本文中における各企業名、製品名等は、それぞれの所有者の商標あるいは登録商標です。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
ザインエレクトロニクス株式会社 経営企画部 高田 康裕
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-3-6 ワカ末ビル 6F
TEL 03-3270-0666 FAX 03-3270-0688
URL: <http://www.thine.co.jp> E-mail: ir@thine.co.jp

以上